

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《關於部分高級管理人員增持公司股份計劃實施完畢暨增持結果的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

中國上海，二零二四年一月四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事：**

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

**非執行董事：**

孫國棟

葉峻

**獨立非執行董事：**

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

A 股代码：688347  
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司  
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-001

## 华虹半导体有限公司

# 关于部分高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 增持计划基本情况：华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）执行董事兼总裁唐均君先生；公司执行副总裁周卫平先生；公司执行副总裁、首席财务官兼信息披露境内代表 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生；公司执行副总裁 Weiran Kong（孔蔚然）先生；公司执行副总裁倪立华先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 30 日（中报窗口期后第一个交易日）起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 225 万元且不超过人民币 450 万元。本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华虹半导体有限公司关于部分高级管理人员增持公司 A 股股份计划的公告》（公告编号：2023-003）。
- 增持计划实施结果：截至 2024 年 1 月 4 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 53,618 股，占公司总股本 0.0031%，增持金额合计为人民币 230.94 万元，本次增持计划已实施完毕。

### 一、增持主体的基本情况

#### （一）增持主体

序号	姓名	职务
1	唐均君	执行董事兼总裁

序号	姓名	职务
2	周卫平	执行副总裁
3	Daniel Yu-Cheng Wang (王鼎)	执行副总裁、首席财务官兼信息披露境内代表
4	Weiran Kong (孔蔚然)	执行副总裁
5	倪立华	执行副总裁

(二) 本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况

本次增持计划实施前，上述增持主体合计持有公司港股股份 417,733 股，占公司总股本的 0.0243%。

## 二、增持计划的主要内容

本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于部分高级管理人员增持公司 A 股股份计划的公告》(公告编号: 2023-003)。

## 三、增持计划的实施结果

2023 年 8 月 30 日至 2024 年 1 月 4 日，增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持 A 股股份 53,618 股，占公司总股本的 0.0031%，增持金额合计为人民币 230.94 万元，本次增持计划已实施完毕。截至 2024 年 1 月 4 日，上述增持主体合计持有公司股份 471,351 股，占公司总股本的 0.0275%。

## 四、其他说明

(一) 增持主体在本次实施增持计划的过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，增持计划实施期限内未减持所持有的公司股份。

(二) 本次增持计划已实施完毕，未导致公司股份分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三) 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、香港《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年1月5日